



Infineon Technologies Packaging Center Regensburg-Burgweinting Eckdaten

Leitstandort für Technologie, Innovation und Marketing
Entwicklung und Fertigung von Modulen für Chipkarten-Anwendungen

Seit 1990 Fertigung von Chipkarten-Modulen in Regensburg
August 2000: Neubau einer Fertigung in Regensburg-Burgweinting

Gesamtfläche:	2.500 m ²
Produktionsvolumen:	670 Millionen Module in Geschäftsjahr 2003/04 (Produktion des 3 Milliardensten Moduls im Juli 2004)
Beschäftigte:	260 (Gesamtbeschäftigte am Standort Regensburg: ca. 2.800)
Produkte und Technologien:	Chipkartenmodule in Wirebond- and FCOS-Technologie Kontaktlose Module in Mold- and FlipChip-Technologie RFID Inlays Preassembly: Waferthinning, dicing, bumping

Das Packaging Center in Regensburg-Burgweinting ist zusammen mit seiner chinesischen Fertigungsstätte in Wuxi weltweit Marktführer bei Chipkartenmodulen.